

NEWS RELEASE

報道資料

2018年11月19日

(日本時間)

アプライド マテリアルズ 新 R&D センター設置計画を発表、
ムーアの法則の限界への取り組みを支援

アプライド マテリアルズ (Applied Materials, Inc., Nasdaq : AMAT、本社 : 米国カリフォルニア州サンタクララ、社長兼 CEO ゲイリー・E・ディッカーソン) は 11 月 15 日 (現地時間)、同社の研究開発機能を大幅に拡充するマテリアルズ エンジニアリング テクノロジー アクセラレーター (META センター) の設置計画を発表しました。長らく指標となっていたムーアの法則に沿った微細化が困難の度を増す中で、同センターはアプライド マテリアルズとのおお客様によるさらなるイノベーションを推進します。

META センターの最大の目的は、お客様に新たな半導体材料とプロセス技術を迅速提供し、半導体の性能、消費電力、コストにブレークスルーをもたらすことにあります。新センターは、アプライド マテリアルズがシリコンバレーに設けているメイダン テクノロジー センターの機能を補完・拡充するものとなります。

META センターは、イノベーション ハブとして機能し、アプライド マテリアルズのディッカーソン CEO の呼びかけに応じて、テクノロジーのエコシステムにまたがる活発なコラボレーションと迅速化を目指します。

アプライド マテリアルズのゲイリー・ディッカーソン社長兼 CEO は、次のように述べています。「人工知能 (AI) とビッグデータのポテンシャルをフルに生かすためには、クラウドとエッジの両面でコンピューティング性能、消費電力、コストを大幅に改善する必要があります。それには、革新的な材料や微細化の手法を用いた新しいコンピューティング アーキテクチャーとチップが必要です。META センターは、お客様と力を合わせて材料からシステムに至るイノベーションを推進する新しいプラットフォームを創出します」

META センターは 2019 年の開設を目指しており、24,000 平方フィート (約 2,230 m²) のクリーンルームを備えた他に類例のない施設となる予定です。ここにはアプライド マテリアルズの各種最先端プロセス装置が設置されるほか、お客様工場での新しいチップ材料やチップ構造の量産に備えたパイロット生産に向け、補完的なテクノロジーも導入されます。

META センターは、ニューヨーク州アルバニーのニューヨーク州立工科大学 (State University of New York Polytechnic Institute: 略称 SUNY Poly) キャンパス内に置かれ、ニューヨーク州、ニューヨーク州立大学研究財団、SUNY Poly との間で締結される合意書に沿って設立される予定です。この合意はすでにエンパイア ステート ディベロップメント (Empire State Development) 理事会の承認を受け、現在はニューヨーク州公共機関管理委員会 (New York State Public Authorities Control Board) の承認を申請しています。

アプライド マテリアルズのニューマーケット&アライアンスグループ シニアバイスプレジデント、スティーブ・ガニヤムは次のように述べています。「ニューヨーク州立工科大学は、インフラ、能力、人材をバランスよく備え、学術・起業の両面で活躍するとともに、半導体業界にもしっかりとした基盤があります。META センターでのコラボレーションを通して材料のイノベーションを加速することで、関連技術のエコシステム全体に恩恵をもたらすことができると考えています」

業界関係者コメント

サムスン研究所:「私たちはプロセス開発におけるアプライド マテリアルズとのコラボレーションを重視しています。この業界は、従来のデバイス微細化を超えた新たなイノベーションを必要としており、新材料の探求もその1つです。アプライド マテリアルズが先進的な R&D 機能を拡充し、お客様にさらなるリソースを提供してチップ開発の加速を図っていることを歓迎します」

台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング・カンパニー (TSMC) バイス プレジデント IT/リスクマネジメント&マテリアルズマネジメント担当 J.K.リン (J.K. Lin) 氏:

「TSMC は、アプライド マテリアルズなど重要なサプライヤーとの協力を装置、材料の両面でより緊密化したいと考えています。協働を通して業界のイノベーションを推進し、高成長の機会をとらえることは、半導体業界最大のエコシステム形成を目指す当社のグランド・アライアンス (大連携) の考え方と一致します」

IBM リサーチ バイス プレジデント ムケシュ・V・カーレ (Mukesh V. Khare) 氏:「IBM とアプライド マテリアルズは、半導体業界にブレークスルーをもたらすことを目指してマテリアルズ エンジニアリング分野で長年協力してきた実績があります。AI は現代における最大の機会の1つで、材料、デバイス、アーキテクチャーのすべてにまたがるイノベーションが求められます。アプライド マテリアルズがニューヨーク州アルバニーに META センターを新設して機能を拡大し、業界の AI 探求を支援することを嬉しく思います」

グローバルファウンドリーズ CEO トム・コールフィールド (Tom Caulfield) 氏：「半導体製造の複雑さとコストが増大しているため、従来のデバイス微細化のペースではもはや最新のテクノロジーノードに対応できなくなっています。アプライド マテリアルズが広範な先進的 R&D に投資し、チップ製造に新材料と新しい組み合わせを投入しようとしていることは、喜ばしい限りです。お客様に対して今後も多様なソリューションを提供できるよう、これからもアプライド マテリアルズとの協働を行っていきます」

ARM フェロー グレグ・イエリック (Greg Yeric) 氏：「ARM のパートナー企業がコンピューティングを高度化できるよう性能と効率を高めることは、プロセスノードがさらに進むなかでトランジスタやインターコネクタの微細化の課題克服につながると考えられます。この分野ではいろいろと斬新なアイデアが探求されていますが、コンセプトから生産までの時間を短縮する必要があり、アプライド マテリアルズが R&D 機能を拡充することで、そうした研究がより促進されるものと期待しています」

シンティアント社 (Syntiant Corp.) CEO カート・ブッシュ (Kurt Busch) 氏：「アプライド マテリアルズは半導体プロセスや製造装置で世界をリードしています。当社はアプライド マテリアルズとの関係をきわめて重視しており、その最新技術が機械学習のエッジデバイスにブレークスルーをもたらすことを願っています」

将来予想に関する記述について

本プレスリリースには、提案された研究開発施設についての計画と期待、業界展望と技術要件、新材料と技術の開発など、将来の見通しに関する記述や、過去の事実には該当しないその他の記述が含まれています。こうした記述やその前提をなす仮定はリスクや不確定要素に左右され、将来のパフォーマンスを保証するものではありません。こうした記述が明示ないし黙示する帰結と実際の結果の間に大きな違いをもたらす得る要因としては、関係当事者が施設の設定に関する合意を成立させる能力；規制当局その他の承認をタイムリーに、ないし実際に取り付ける能力；半導体需要、およびお客様からの技術要件；当社がイノベティブな新技術を開発する能力；当社が主要テクノロジーに関する知的財産権を取得ならびに保護する能力；当社が提案された施設の運用目的を達成する能力；当社が証券取引委員会 (SEC) に提出する書類 (最新の Form 10-Q および 8-K 報告書を含む) に記載しているその他のリスクや不確定要素などがあります。将来の見通しに関する記述はすべて、経営陣の現時点における推定、予測、仮定に基づくもので、アプライド マテリアルズはこれらの記述を更新する義務を負っておりません。

アプライド マテリアルズ(Nasdaq: AMAT)は、マテリアルズ エンジニアリングのソリューションを提供するリーダーとして、世界中のほぼ全ての半導体チップや先進ディスプレイの製造に寄与します。原子レベルの材料制御を産業規模で実現する専門知識により、お客様が可能性を現実に変えるのを支援します。アプライド マテリアルズはイノベーションを通じて未来をひらく技術を可能にします。

詳しい情報はホームページ:<http://www.appliedmaterials.com> でもご覧いただけます。

このリリースは 11 月 15 日米国においてアプライド マテリアルズが行った英文プレスリリースをアプライド マテリアルズ ジャパン株式会社が翻訳の上、発表するものです。

アプライド マテリアルズ ジャパン株式会社(本社:東京都、代表取締役社長:中尾 均)は1979年10月に設立。大阪支店のほか14のサービスセンターを置き、日本の顧客へのサポート体制を整えています。

このリリースに関する詳しいお問い合わせは下記へ
アプライド マテリアルズ ジャパン株式会社 (Tel: 03-6812-6801)
ホームページ: <http://www.appliedmaterials.com>
